



2021年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2020年10月26日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 2760 URL <https://www.teldevice.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳重 敦之
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 045-443-4000
 四半期報告書提出予定日 2020年11月9日 配当支払開始予定日 2020年12月1日
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有
 四半期決算説明会開催の有無 : 有 (アナリスト・機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

1. 2021年3月期第2四半期の連結業績(2020年4月1日~2020年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2021年3月期第2四半期	61,901	△5.1	1,122	△17.9	1,261	△5.9	823	△4.8
2020年3月期第2四半期	65,213	△5.2	1,367	△19.6	1,340	△3.6	864	△3.3

(注) 包括利益 2021年3月期第2四半期 786百万円(△5.1%) 2020年3月期第2四半期 828百万円(△18.9%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2021年3月期第2四半期	81.94	—
2020年3月期第2四半期	84.78	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2021年3月期第2四半期	81,064	27,463	33.1
2020年3月期	76,539	27,141	34.6

(参考) 自己資本 2021年3月期第2四半期 26,797百万円 2020年3月期 26,476百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2020年3月期	—	40.00	—	50.00	90.00
2021年3月期	—	40.00	—	—	—
2021年3月期(予想)	—	—	—	68.00	108.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2021年3月期の連結業績予想(2020年4月1日~2021年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	138,000	1.9	4,100	14.7	2,700	18.0	269.36

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料8ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

2021年3月期2Q	10,445,500株	2020年3月期	10,445,500株
------------	-------------	----------	-------------

② 期末自己株式数

2021年3月期2Q	384,454株	2020年3月期	421,568株
------------	----------	----------	----------

③ 期中平均株式数（四半期累計）

2021年3月期2Q	10,046,745株	2020年3月期2Q	10,195,435株
------------	-------------	------------	-------------

(注) 当社は、役員報酬BIP信託及び信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship）を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)	8
(追加情報)	8
(セグメント情報)	9
3. その他	10
(1) 仕入、受注及び販売の状況	10

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大懸念が続く中、各種政策により経済活動の再開は進められているものの、企業収益は大幅な減少が続くなど、依然として厳しい状況となりました。

このような事業環境のもと、当社グループにおける当第2四半期連結累計期間の経営成績については、売上高61,901百万円（前年同期比5.1%減）、営業利益1,122百万円（前年同期比17.9%減）、経常利益1,261百万円（前年同期比5.9%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益823百万円（前年同期比4.8%減）となりました。

当社グループにおける報告セグメントに係る経営成績については、次のとおりであります。

(半導体及び電子デバイス事業)

経済活動の正常化に向け、半導体市場は一部で需要の好転が見受けられましたが、コロナ禍や米中貿易摩擦の影響等、不透明な状況は続いております。中国における生産水準が回復傾向にある中、当社グループが取り扱う産業機器向け製品の需要は堅調に推移し、顧客商権の拡大も概ね当初の見通しに基づき進捗したものの、新型コロナウイルス感染症の影響による消費の落ち込みや製造業における工場稼働率の低下に伴い、車載・OA関連機器向け製品の販売が低調に推移したことなどから、当第2四半期連結累計期間は売上高51,475百万円（前年同期比5.2%減）、セグメント利益（経常利益）221百万円（前年同期比50.3%減）となりました。

(コンピュータシステム関連事業)

新型コロナウイルス感染症の影響によりリモートワークの活用が進むなど、ストレージやセキュリティ製品に対する需要は増しております。その一方、当社では2020年2月21日に公表した主要取引先との販売代理店契約解消によって取り扱い製品が減少したことから、当第2四半期連結累計期間は売上高10,426百万円（前年同期比4.6%減）となりましたが、ネットワーク及びストレージ関連機器販売に付随する運用・保守サービスが好調に推移したことなどによりセグメント利益（経常利益）は1,040百万円（前年同期比16.2%増）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第2四半期連結会計期間末における総資産は81,064百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,525百万円の増加となりました。これは主に、売上債権が減少した一方でたな卸資産が増加したことによります。負債総額は53,600百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,202百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金が増加した一方で長期借入金が増加したことによります。また、純資産は27,463百万円となり、前連結会計年度末に比べ322百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は33.1%となり、前連結会計年度末に比べ1.5ポイント低下いたしました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後も経済活動の再開や工場稼働率の回復が続く、半導体及び電子デバイス事業においては顧客商権の拡大が見込まれるものの、現時点では新型コロナウイルス感染症の拡大懸念が払拭されていないことなどを踏まえ、前回（2020年4月28日）公表の通期連結業績予想は変更せず、据え置くことといたしました。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,492	5,220
受取手形及び売掛金	32,874	29,652
電子記録債権	1,869	1,543
商品及び製品	20,965	27,253
原材料	860	963
その他	7,619	8,632
貸倒引当金	△12	△6
流動資産合計	68,668	73,258
固定資産		
有形固定資産	1,952	1,859
無形固定資産	1,806	1,769
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	55	88
その他	4,102	4,136
貸倒引当金	△47	△47
投資その他の資産合計	4,111	4,177
固定資産合計	7,870	7,806
資産合計	76,539	81,064

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2020年9月30日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	9,982	9,254
短期借入金	6,681	5,002
1年内返済予定の長期借入金	3,040	3,040
前受金	7,687	10,124
賞与引当金	1,214	1,040
その他	2,447	1,872
流動負債合計	31,054	30,334
固定負債		
長期借入金	9,604	14,491
退職給付に係る負債	7,839	7,886
その他	899	888
固定負債合計	18,344	23,266
負債合計	49,398	53,600
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,645	5,645
利益剰余金	19,129	19,429
自己株式	△944	△856
株主資本合計	26,325	26,714
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	29	62
繰延ヘッジ損益	△57	△69
為替換算調整勘定	137	70
退職給付に係る調整累計額	40	19
その他の包括利益累計額合計	150	83
非支配株主持分	665	666
純資産合計	27,141	27,463
負債純資産合計	76,539	81,064

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
売上高	65,213	61,901
売上原価	55,824	53,126
売上総利益	9,389	8,775
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	3,211	3,315
賞与引当金繰入額	1,001	929
退職給付費用	414	322
その他	3,394	3,085
販売費及び一般管理費合計	8,021	7,653
営業利益	1,367	1,122
営業外収益		
持分法による投資利益	21	47
為替差益	-	64
その他	69	75
営業外収益合計	90	187
営業外費用		
支払利息	57	35
為替差損	39	-
その他	20	12
営業外費用合計	117	48
経常利益	1,340	1,261
特別利益		
固定資産売却益	0	1
特別利益合計	0	1
特別損失		
固定資産売却損	0	0
固定資産除却損	2	8
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額	0	0
関係会社清算損	5	-
持分変動損失	-	19
特別損失合計	9	29
税金等調整前四半期純利益	1,331	1,233
法人税等	426	380
四半期純利益	905	853
非支配株主に帰属する四半期純利益	40	30
親会社株主に帰属する四半期純利益	864	823

四半期連結包括利益計算書

第2四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
四半期純利益	905	853
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△5	32
繰延ヘッジ損益	△42	△11
為替換算調整勘定	△78	△59
退職給付に係る調整額	48	△21
持分法適用会社に対する持分相当額	0	△7
その他の包括利益合計	△77	△67
四半期包括利益	828	786
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	787	755
非支配株主に係る四半期包括利益	40	30

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月 1日 至 2019年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月 1日 至 2020年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益	1,331	1,233
減価償却費及びその他の償却費 のれん償却額	273	283
賞与引当金の増減額 (△は減少)	17	17
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	△318	△172
支払利息	72	△2
為替差損益 (△は益)	57	35
売上債権の増減額 (△は増加)	△43	△70
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,555	3,415
仕入債務の増減額 (△は減少)	△398	△6,303
未払金の増減額 (△は減少)	638	△700
前受金の増減額 (△は減少)	△227	△90
未収消費税等の増減額 (△は増加)	2,454	2,439
未収入金の増減額 (△は増加)	△10	△192
前払費用の増減額 (△は増加)	173	△399
持分変動損益 (△は益)	△724	△584
その他	-	19
小計	△31	△165
利息及び配当金の受取額	6,818	△1,236
利息の支払額	7	10
法人税等の支払額	△57	△36
営業活動によるキャッシュ・フロー	△516	△532
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	6,251	△1,794
無形固定資産の取得による支出	△341	△257
関係会社の清算による収入	△50	△31
その他	44	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7	△1
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	△354	△290
長期借入れによる収入	△3,825	△1,596
長期借入金の返済による支出	-	5,000
自己株式の処分による収入	△105	△113
配当金の支払額	68	81
非支配株主への配当金の支払額	△553	△501
その他	△20	△28
財務活動によるキャッシュ・フロー	△18	△23
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,455	2,818
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△15	△11
現金及び現金同等物の期首残高	1,426	721
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	3,534	4,218
現金及び現金同等物の四半期末残高	70	-
	5,032	4,939

(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用)

税金費用については、当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症について、緊急事態宣言は解除されたものの収束時期等を正確に予想することは困難な状況にあります。このような状況の中、当社グループは前連結会計年度末後の経営状況等を勘案して会計上の見積りを行っておりますが、現時点においてその基礎となる仮定に重要な変更はありません。

(セグメント情報)

I 前第2四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	54,282	10,930	65,213	—	65,213
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	54,282	10,930	65,213	—	65,213
セグメント利益	444	895	1,340	—	1,340

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

II 当第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	51,475	10,426	61,901	—	61,901
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	51,475	10,426	61,901	—	61,901
セグメント利益	221	1,040	1,261	—	1,261

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

3. その他

(1) 仕入、受注及び販売の状況

① 仕入実績

当第2四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	51,987	8.3
コンピュータシステム関連事業	7,323	△9.7
合計	59,310	5.7

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 受注実績

当第2四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	53,585	△1.0	25,960	17.1
コンピュータシステム関連事業	12,727	8.1	16,982	38.0
合計	66,313	0.6	42,943	24.6

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 販売実績

当第2四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	51,475	△5.2
コンピュータシステム関連事業	10,426	△4.6
合計	61,901	△5.1

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。